

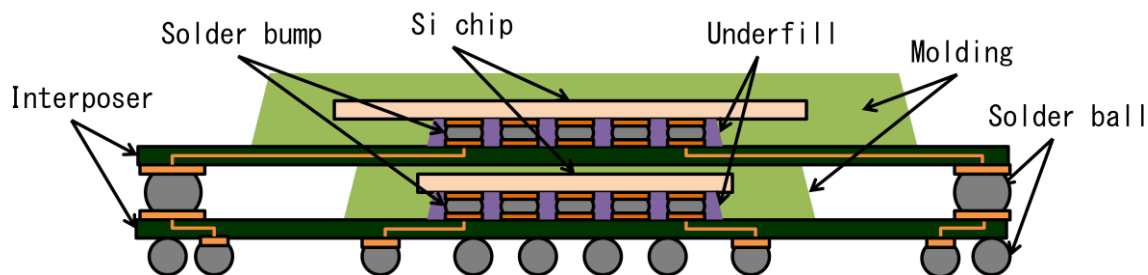
半導體封裝材料阿爾法射線委託分析服務

2017年6月13日

三菱綜合材料

三菱綜合材料運用多年以來累積關於阿爾法射線的評估及技術，將推出焊材以及各種半導體封裝周邊材料的阿爾法射線分析及評估服務。

對象產品:錫球/凸塊、基板、底部填充膠、綠漆、及其他(歡迎洽詢)



Construction of PoP packaging (Flip chip type)

近年來，由於 2.5D 及 3D 封裝等封裝技術的進步，不只是晶片下的凸塊，構裝材料如綠漆、底部填充膠等，也同時被要求提高對阿爾法射線的控管。

為了要協助客戶對阿爾法射線管理嚴格把關，藉由開發低阿爾法射線焊材「MUL α S 系列」產品時所累積的豐富知識及經驗，本公司推出了阿爾法射線委託分析之服務。

分析概要

- 分析設備：Gas flow proportional counter
- 分析方法：依據 JEDEC STANDARD JESD221
- 分析樣品：各種晶圓、金屬板、電鍍薄膜、焊錫膏、各種粉末(有揮發性的粉末除外)、樹脂薄板等。
- 交期：約 2 星期（依個別情況可討論）
- 價格：另外提出報價

任何相關疑問，請與業務負責窗口洽詢。

所需樣品

<晶圓、電鍍板、薄板等>

- 樣品厚度：~5mm
- 面積：1,000cm²（鋪在 28x36cm 的托盤）
⇒1,000cm² 以下的面積也可測量，但請先與本公司洽詢。
- 重量：~1,500g

提供樣品時請附 SDS。

<各種粉末>

- 重量：500~1,000g
⇒請準備可塗在 28x36cm 的托盤上（面積：1,000cm²），厚約 1~2mm 的樣品份量。

聯繫三菱綜合材料

China	MMC SHANGHAI CO., LTD. Room 12B01, Winners Building 678, Gubei Road, SHANGHAI, 200336, China Phone +86-(0)21-6289-0022 Fax +86-(0)21-6279-1180
Taiwan	EUCARLA INDUSTRIAL CO., LTD. 19F-3, No. 56 Min-Sheng 1st Rd., Kaohsiung, 800 Taiwan Phone +886-7-2270999 Fax +886-7-2270998
	MMC ELECTRONIC MATERIALS TAIWAN CO.,LTD. TAIPEI OFFICE 8F-1, No.35 Kan-Ku Street, Taipei 103, TAIWAN R.O.C. Phone + 886(2)2558-2895 Fax + 886(2)2556-0035

您也可經由以下網站聯繫本公司

【三菱綜合材料 電子材料事業 功能材料事業部】

<http://www.mmc.co.jp/adv/ele/zh/index.html>